

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-04-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	汇添富基金、南方基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、浙商基金、中金公司、永安保险、农业银行、中泰证券、海通证券、东北证券、东吴证券、太平洋证券、民生证券、银河证券、德邦证券、平安证券、东方财富证券、汇丰前海证券、东方证券、招商证券、南京证券、万联证券、国海证券、华安证券、上海懿坤资产、浙江韶夏投资、深圳嘉石大岩资本、上海明河投资、华泽股权投资、深圳尚诚资产、中和资本、浙江君弘资产等机构
时间	4月26日、4月27日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 王渝、陈小曼、肖晓月
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、公司 2021 年度经营情况及未来计划</p> <p>报告期内，公司实现了 2010 年上市以来最大的扣非净利润增长幅度，经营情况与业绩快报预计基本一致，实现营业收入 503,998.71 万元、同比增长 24.92%；归属于上市公司股东的净利润 62,149 万元、同比增长 19.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,097.82</p>

万元、同比增长 102.46%；总资产 830,221.83 万元、较上年末增长 34.69%；归属于上市公司股东的净资产 376,238.41 万元、较上年末增长 14.38%。

公司销售收入平稳增长，受益于 PCB 和 IC 封装基板产能逐步释放，各业务板块均呈现良好的发展态势。净利润大幅增长的原因主要是基于公司管理持续改善、经营效率显著提升，整体毛利率提升 1.24 个百分点，期间费用率下降 1.87 个百分点。其中：销售费用率下降 0.41 个百分点，管理费用率下降 0.33 个百分点，研发费用率下降 0.18 个百分点，财务费用率下降 0.95 个百分点。

公司各业务板块经营情况如下：

（一）PCB业务平稳增长，盈利能力提升

报告期内，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入379,432.60万元、同比增长22.95%；毛利率33.13%、同比提升0.56个百分点。子公司宜兴硅谷在保持稳定运营的基础之上，持续推动产品升级和战略大客户突破，实现交付、良率、经营效率的提升，全年实现收入67,391.46万元、同比增长66.39%；净利润6,322.45万元、同比增长79.68%。欧洲市场表现良好，Fineline把握住欧洲经济复苏的契机，实现收入128,932.20万元、同比增长28.83%；净利润11,366.09万元、同比增长51.61%。英国Exception实现收入6,746.40万元、同比增长1.30%；净利润595.29万元，实现稳定盈利。

（二）半导体业务维持高景气度，全力推动扩产

报告期内，公司半导体业务实现收入108,340.61万元、同比增长29.19%，毛利率24.04%、同比提升2.84个百分点。

其中，IC封装基板业务呈现产销两旺的格局，实现收入66,653.49万元、同比增长98.28%；毛利率26.35%、同比提升13.35个百分点。广州基地2万平米/月的产能实现满产满销，整体良率保持在96%左右。

半导体测试板业务因广州基地新产能于年中投产而贡献有限，未能实现营收增长，全年实现营收41,687.12万元、同比下滑17.03%；毛利率20.34%、同比下滑6.35个百分点。其中，Harbor受美国本土疫情影响实现营收35,999.15万元、同比下滑7.33%；净利润3,826.62万元、同比增长29.79%。随着广州基地的产能逐步释放，交期和良率指标的改善，2022年公司半导体测试板业务有望重回增长轨道。

公司历来重视回馈投资者，上市以来坚持每年现金分红，今年拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），分红规模为历年新高。

2022年第一季度业绩预告已公告，公司整体收入规模保持增长态势，主要系子公司宜兴硅谷产能释放、订单增加；广州科技刚性电路板项目产能稳步提升，IC封装基板业务订单饱满；海外子公司Fineline稳定增长。2022年一季度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为18,000万元-21,000万元、比上年同期增长77.49%-107.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,500万元-12,500万元、比上年同期增长5.00%-14.13%。扣非净利润受公司2021年员工持股计划费用摊销、广州兴科IC封装基板建设项目及FCBGA封装基板项目的人工成本等因素影响（合计超2,000万元），增速有所放缓。

未来公司将继续保持战略定力，推动广州兴科IC封装基板项目的投资扩产及广州FCBGA项目的投资建设，并积极提升自身的能力以应对宏观经济层面的不确定性和行业层面的竞争压力。

二、广州FCBGA项目的建设进度情况及产能落地情况

广州FCBGA项目已启动项目建设前期准备工作，同步启动设备采购工作，计划2023年底前后进入试产阶段。

三、珠海兴科产能释放节奏介绍

珠海兴科IC封装基板项目一期1.5万平米/月的产线已建成，目前已进入样品生产阶段，预计6月份开始进入小批量生产阶段，今年年底实现单月90%以上的产能利用率目标。之后再分批建设3万平米/月的产能，初步计划在2023年底前建成投产。

四、IC封装基板下游应用及客户情况介绍

存储类载板是BT载板领域最大的下游市场，也是公司目前主要目标市场。公司目前IC封装基板下游占比为：存储类占比约2/3，指纹识别、射频、物联网相关占比约1/3，预计未来将维持前述产品结构。客户占比情况为：大陆客户占比约2/3，台湾客户占比约20%，韩系客户占比约10%，下游大陆厂商正在积极扩产，是未来的主要增量市场所在。

五、定增项目的节奏

公司定增项目已经接触了不少有认购意向的投资者。但公司2021年利润分配方案尚待提请股东大会审议及实施，根据相关法规规定，利润分配实施完毕前不得发行，因此预计将在分红实施完毕之日起至2022年10月定增批文有效期届满之日择机发行。

六、公司未来的战略方向

	<p>基于对产业趋势的判断、客户需求及公司自身技术、产品升级需要，公司未来的重点工作是推动广州兴科 IC 封装基板项目的投资扩产及广州 FCBGA 项目的投资建设。传统 PCB 业务也是公司的主要收入和利润贡献来源之一，未来主要通过提升研发能力、数字化改造、加强与大客户的合作深度等方面来提升传统 PCB 业务的竞争力，实现效率提升和平稳增长。长期来看，随着公司 IC 封装基板业务的逐步投产和达产，未来半导体业务的收入和利润占比将会逐步提升。</p>
附件清单	无
日期	4 月 27 日